

明新科技大學 2021 工程科技

技術應用 研討會

徵求論文 Call for Paper

近年來隨著半導體技術、智慧物聯網、智慧製造、系統控制、綠色能源、大數據、人工智慧、數據管理、多媒體技術與5G等技術不斷演進，推動工程科技應用快速發展，工程技術整合應用系統涵蓋科技領域非常廣泛，包含電子、電機、機械、光電、化材、環境、通訊、資工、資管、多媒體虛擬實境等多方面。

為增進產、學、研界在相關領域之交流，本校工程學院與半導體學院在2021年底辦理本研討會，藉由本研討會公開徵求論文，並邀請各界代表，就相關領域主題共同投稿與研討，用以分享交流師生以及業界之研發成果。所有被接受之論文都將收錄在本研討會論文集，以供分享與交流。

投稿說明

截稿時間：2021 / 11 / 19

審稿通知：2021 / 11 / 26

舉辦日期：2021 / 12 / 17

投稿費用：全程免費

- 請以全文投稿，A4紙張6-10頁，中英文皆可，全文將收錄於論文集。
- 投稿與論文格式請參閱網址
<https://2021mustpaper.blogspot.com>
- 投稿之論文若是格式不符合規定，主辦單位將逕行修改，不另行通知。
- 論文內容若有涉及抄襲、造假、重複投稿等違反學術倫理者一律退稿。

辦理地點：明新科技大學管理大樓一樓哈佛講堂

主辦單位：明新科技大學工程學院、半導體學院

協辦單位：明新科技大學機械系、電機系、電子系、化材系、土環系、光電系、資工系、資管系與多遊系。

聯絡人：蘇東興老師 (03-5593142~3486、0953-842275、thsu@must.edu.tw)

論文主題 包含(但不限於)下列各領域

- 1 半導體技術(設計、製程、封測等)
- 2 智慧製造精密加工技術與應用
- 3 機器人系統技術與應用
- 4 控制技術應用
- 5 軌道工程技術與應用
- 6 電能電力控制與應用
- 7 光電元件材料與應用
- 8 機電整合技術與應用
- 9 通訊技術與應用
- 10 人工智慧技術與應用
- 11 數據與資訊管理技術與應用
- 12 嵌入式系統技術與應用
- 13 物聯網技術與應用
- 14 製造與材料數與應用
- 15 影像處理技術與應用
- 16 多媒體遊戲設計技術與應用
- 17 工程教學實踐計畫
- 18 其他工程相關技術與應用

